

微細構造解析

【分析方法】

- HR - TEM (高分解能透過型電子顕微鏡)
- UHR - FE - SEM (超高分解能電界放射走査型電子顕微鏡)

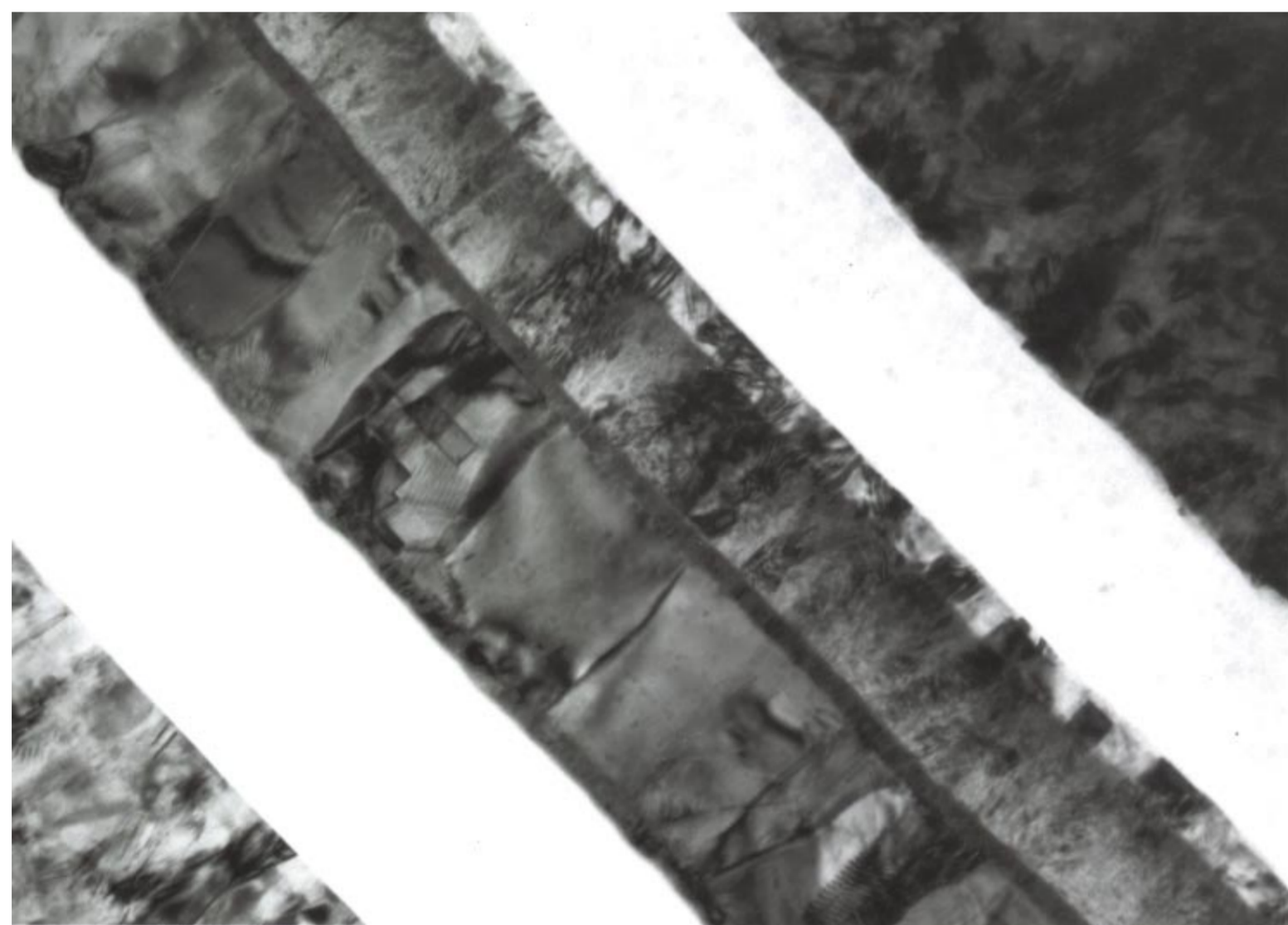
【特徴】

- HR - TEM : 極微小領域の組織解析、結晶構造解析および元素分析
- UHR - FE - SEM : 直接観察倍率 $\times 30 \sim \times 80$ 万倍

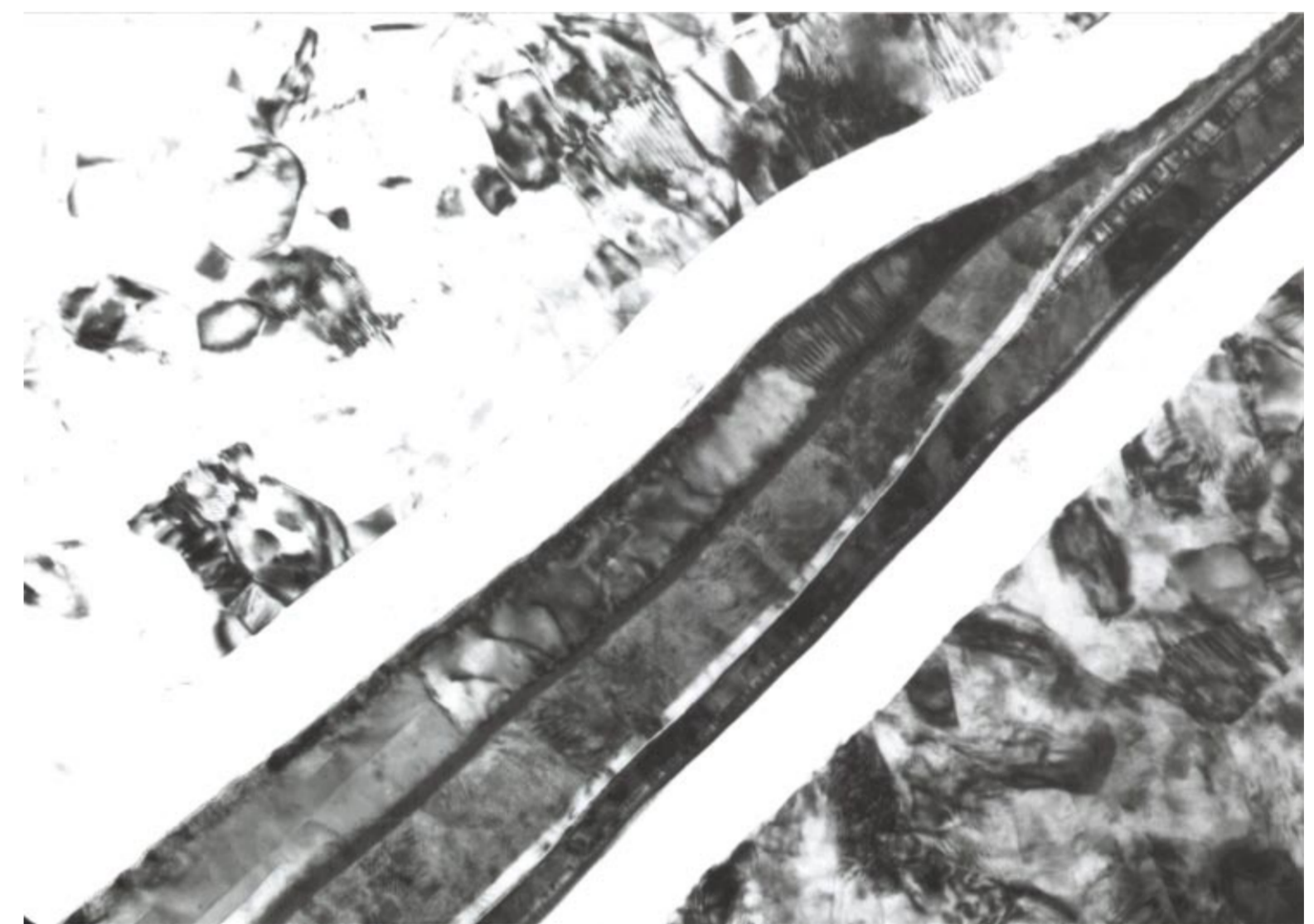
【適用分野】

- HR - TEM : 金属、セラミックス等微小部結晶構造解析、多層薄膜構造組成観察
- UHR - FE - SEM : 微小領域の形態、組織観察

磁気ヘッド断面構造解析

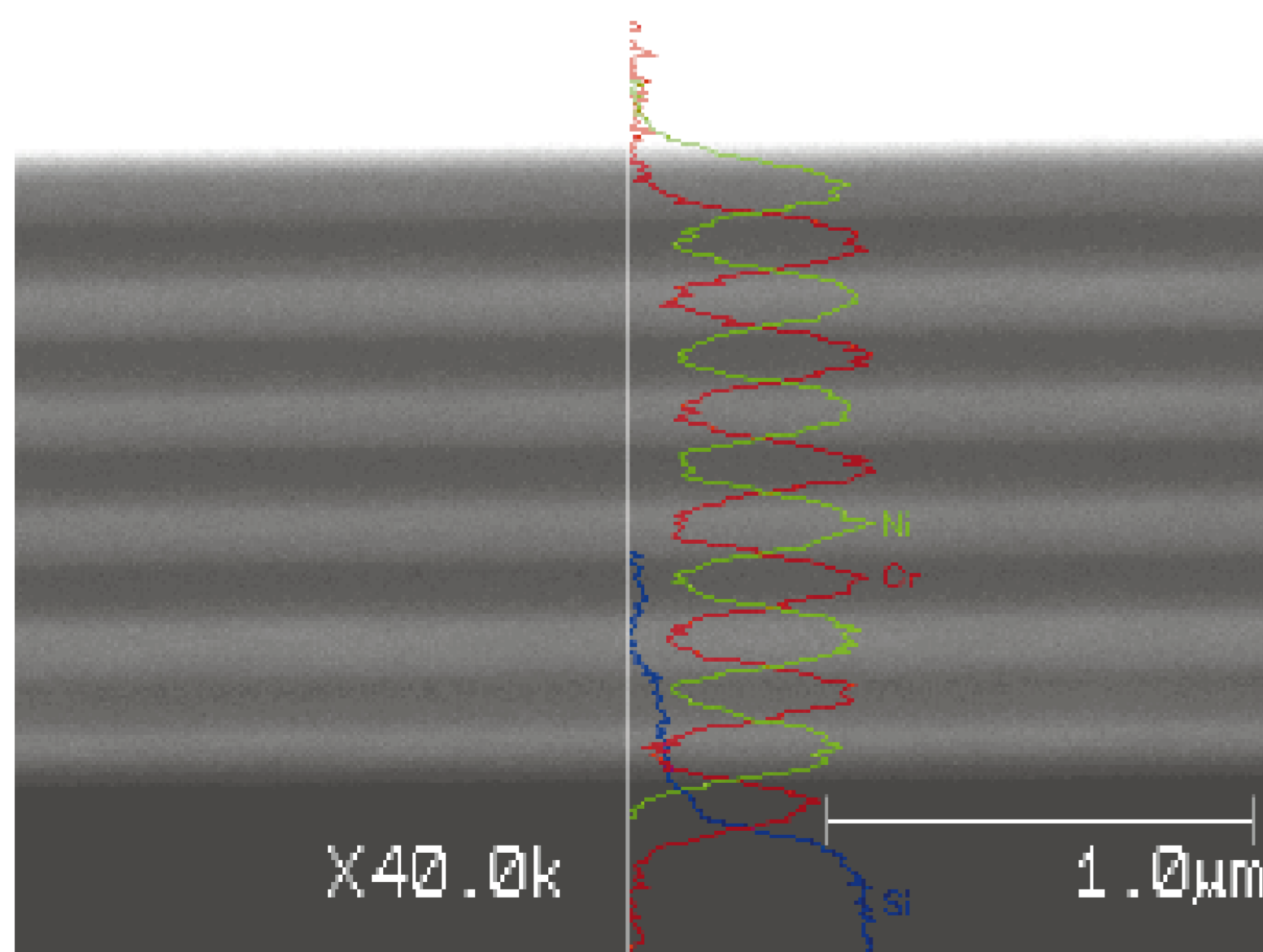


$\times 140,000$



$\times 140,000$

Ni / Cr多層膜の断面構造解析



LSIメモリ断面構造解析



$\times 14,000$